

BERICHTIGTE FASSUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
29. Januar 2004 (29.01.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/010220 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G03D 5/04**,
B05C 5/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/007494

(22) Internationales Anmeldedatum:
10. Juli 2003 (10.07.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 32 984.2 19. Juli 2002 (19.07.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **STEAG HAMATECH AC** [DE/DE]; Ferdin-
and-Von-Steinbeis-Ring 10, 75447 Sternenfels (DE).
INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; Bal-
anstrasse 73, 81541 Munich (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **SCHWERSENZ**,
Anatol [DE/DE]; Hombergstrasse 29, 74821 Mosbach
(DE). **SAULE, Werner** [DE/DE]; Kurt-Eisner-Strasse
41, 81735 München (DE). **NÖRING, Andreas** [DE/DE];
Badener Strasse 9a, 78315 Radolfzell (DE). **DRESS, Peter**

[DE/DE]; Holzmann 18, 76646 Bruchsal (DE). **BURGEL**,
Christian [DE/DE]; Reichenaustrasse 18, 81243 München
(DE). **TSCHINKL, Martin** [DE/DE]; Mühlerweg 17,
81243 München (DE). **STROBL, Marlene** [DE/DE];
Schillerstrasse 12, 01326 Dresden (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, JP, KR, SG,
US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

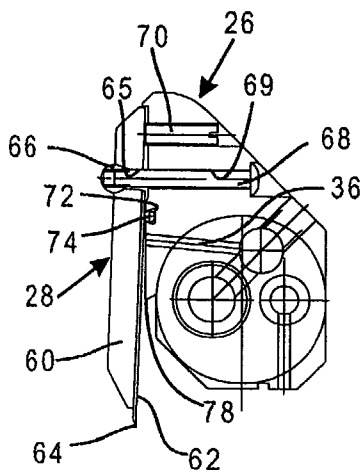
(48) Datum der Veröffentlichung dieser berichtigten
Fassung: 22. April 2004

(15) Informationen zur Berichtigung:
siehe PCT Gazette Nr. 17/2004 vom 22. April 2004, Sec-
tion II

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: NOZZLE ASSEMBLY FOR APPLYING A LIQUID TO A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: DÜSENANORDNUNG ZUM AUFBRINGEN EINER FLÜSSIGKEIT AUF EIN SUBSTRAT



(57) Abstract: The aim of the invention is to achieve a rapid, homogeneous ap-
plication of a liquid with as little force as possible to a substrate. To achieve this,
the invention provides a nozzle assembly (22) for applying a liquid to a substrate,
said assembly having a nozzle body (26) comprising a plurality of nozzles (36) that
are substantially arranged in a line and a guide plate (28) that extends essentially
in a vertical direction with a straight lower edge. According to the invention, the
nozzles (36) above the lower edge are directed towards the guide plate (28) in such
a way that a film of liquid forms on the guide plate (28) and flows over the lower
edge (64).

(57) Zusammenfassung: Für ein rasches, homogenes und möglichst kräftefreies
Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat ist gemäss der vorliegenden Erfin-
dung eine Düsenanordnung (22) zum Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat
vorgesehen, wobei die Vorrichtung einen Düsenkörper (26) mit einer Vielzahl von
im Wesentlichen auf einer Linie angeordneten Düsen (36) und eine sich im We-
sentlichen vertikal erstreckende Umlenkplatte (28) mit einer geraden Unterkante
aufweist, und wobei die Düsen (36) oberhalb der Unterkante auf die Umlenkplatte
(28) gerichtet sind, so dass sich ein Flüssigkeitsfilm auf der Umlenkplatte (28) bil-
det, der über die Unterkante (64) abfließt.

WO 2004/010220 A1